2019 年 10 月 25 日

プレスリリース

NEDO 事業「高効率・高速処理を可能とする AI チップ・次世代コンピューティング技術開発に係るアイデア発掘のための課題調査」に採択決定

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(本社: 東京都中野区、代表取締役社長 CEO 山本達夫、以下 DMP)は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(本部所在地:川崎市幸区 理事長:石塚博昭 以下 NEDO)の調査委託事業である「高効率・高速処理を可能とする AI チップ・次世代コンピューティングの技術開発/高効率・高速処理を可能とする AI チップ・次世代コンピューティング技術開発に係るアイデア発掘のための課題調査(以下、本調査)」に採択されたことをご案内します。

AI 等のコンピューティング技術分野においては、目まぐるしいスピードで技術革新が起き、世界中で新しいアイデアが次々と生まれています。本調査は、我が国だけでなく世界の技術者、研究者、学生等が課題への挑戦を行う「AI エッジコンテスト」の運営を通して、新しいアイデアや人材の発掘、調査等を行うものであります。
DMP は、人口減とそれに伴う少子高齢化等の社会課題の解決や安心・安全社会の実現に果たすエッジ AI 技術の役割は非常に重要と考えており、それに係る人材育成・強化やアイデアの発掘に今後も貢献してまいります。

◆本調査の概要
本調査は、DMP と、国内最大級の会員基盤(22,000 名)を持つコンテストサイト「SIGNATE」を保有し、企業・行政の AI 技術アイデアコンテストを実施している株式会社 SIGNATE が共同で行うもので、昨年度実施された第1回 AI エッジコンテスト(アルゴリズムコンテスト)※の結果を受けた複数回の AI エッジコンテスト(実装コンテストとアルゴリズムコンテスト)の運営・実施、AI エッジコンテスト向けデータの取得とデータセット追加作成、ならびにアイデア・課題等の調査・分析を行います。
DMP は、AI アルゴリズム、ソフトウェア、ハードウェアの一貫した開発体制を持つ強みを活かし、主にエッジデバイスへの AI 実装(AI アルゴリズムを FPGA 等に搭載する)コンテストの開催・運営、データセット構築、ならびに収集したアイデアの調査・分析やアイデア発掘のための効果・課題の取りまとめ(株式会社 SIGNATE と共同)を担当します。

※ 第1回 AI エッジコンテストについては、以下をご参照ください。
https://lp.signate.jp/ai-edge-contest/ja/

◆本調査の期間
2019 年 8 月～2021 年 2 月

■ 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)について

DMP は、独自開発した組込機器向け 2D／3D グラフィックス技術のハードウェア IP やソフトウェア IP のライセンス、ならびにこれらの IP を搭載したグラフィックス LSI 事業を展開する研究開発型のファブレス半導体ベンダーです。近年は AI 分野において世界をリードする「AI Computing Company」となるべく、AI プロセッサ IP、ハード/ソフト製品、サービスを含む幅広いポートフォリオと独自に構築した AI エコシステムを通じたソリューションの提供を行っております。

©2019 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル DMP、DMP ロゴは株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルの登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル
セールス＆マーケティング部　梅田宗敬 / 経営企画部　大澤　剛
TEL:03-6454-0450
e-mail:info_06@dmprof.com
Web サイト: http://www.dmprof.com/jp/contact/